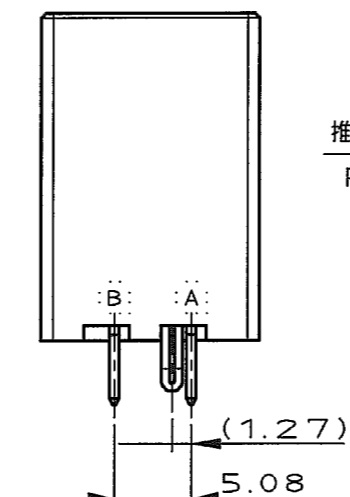
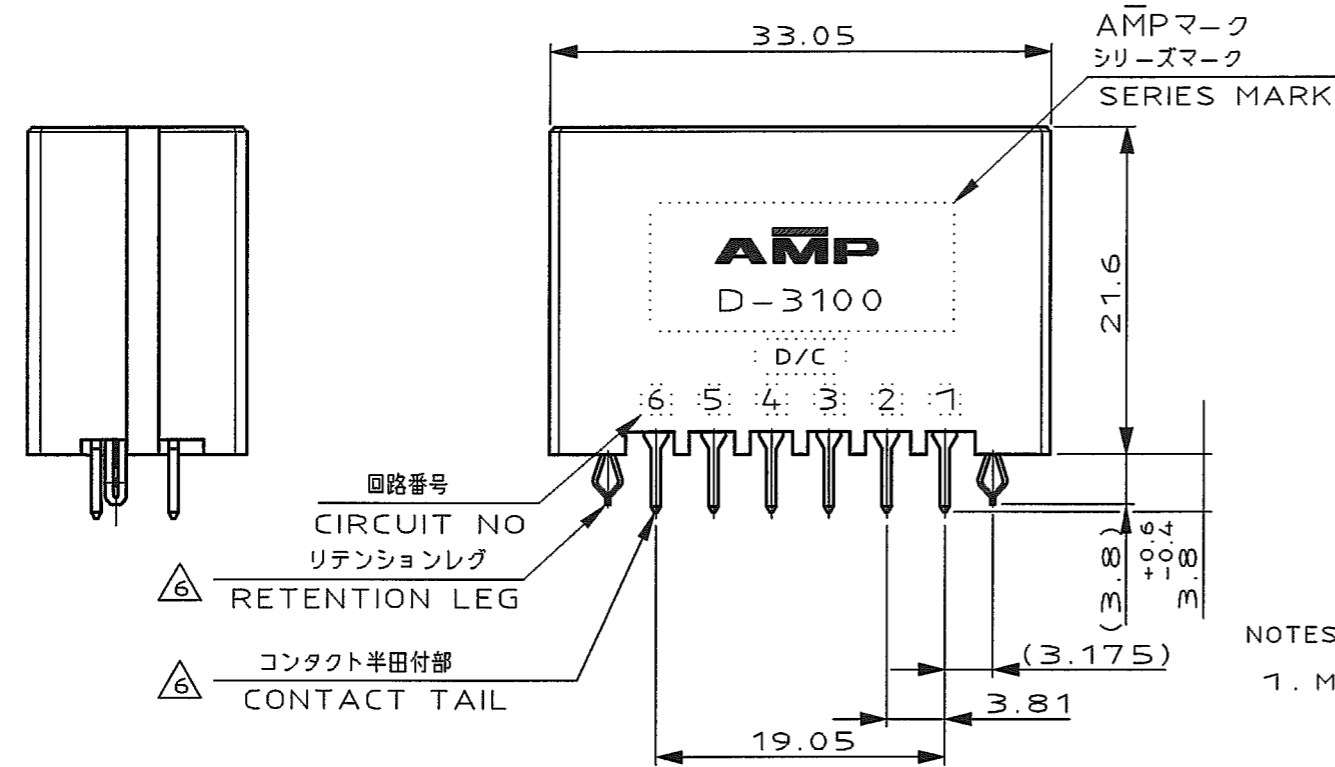
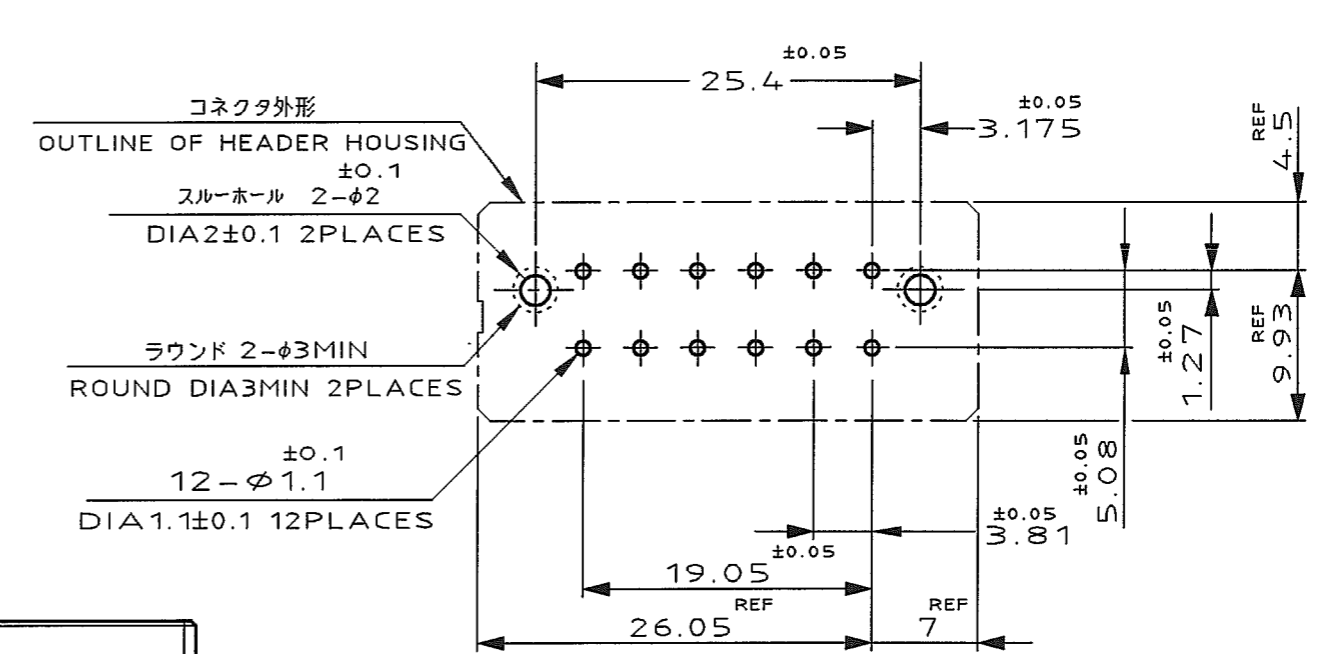
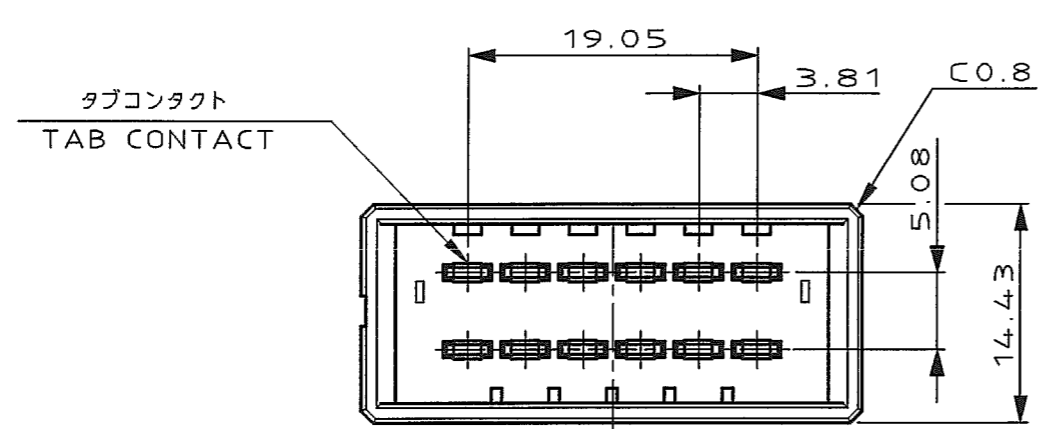


NUMBER 178326
METRIC

3rd ANGLE PROJECTION
DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT
PRINT DIST



推奨基板取付け寸法
PC 基板厚: 1.6±0.1 (非累積公差) (コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN
PC BOARD THICKNESS: 1.6±0.1 (NOT ACCUMULATE TOLERANCE) (CONNECTOR MOUNT SIDE)

- NOTES
- MATERIAL: HOUSING: GLASS FILED THERMO PLASTIC, POLYESTER (94V-0), COLOR: BLACK
CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
 - FINISH (CONTACT AREA): 0.38 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
 - FINISH (CONTACT AREA): 0.76 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
 - FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
 - FINISH (RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
 - FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- 注記
- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂 (94V-0), 色: 黒
コンタクト: 銅合金
リテンションレグ: 銅合金
 - めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.38 μm MIN 金めっき
 - めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.76 μm MIN 金めっき
 - めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 2.0 μm MIN スズめっき
 - めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の上に半田めっき
 - めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の上にスズめっき

△6	△4	178326-5
△6	△3	178326-3
△6	△2	178326-2
(FINISH)		製品番号 (PART NO.)

Copyright © 1995 AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				Tyco Electronics Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
WIRE RANGE		INSULATION DIA		NAME	
mm (AWG)		mm		12 POS DOUBLE ROW VERTICAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC D-3100	
MATERIAL		FINISH		一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	
SEE NOTE 注記参照		SEE NOTE 注記参照		10% ±0.3	
DR. 23 JUN 95 N. Matsubara		DE. 23 JUN 95 N. Matsubara		10% ±0.4	
CHK. 30 JUN 95 Y. ISHIKAWA		APP. 3 JUL 95 S. MANABE		30% ±0.45	
LTR REVISION RECORD		DR CHK DATE		SCALE 2-1	
				REV. B	
				SHEET 1 OF 1	